



# 第十届中国系统级封装大会 SiP Conference China 2026

2026.8.25-27

深圳会展中心(福田)

All for AI, All for GREEN  
为AI和双碳提供全栈技术与供应链支持



扫码了解更多信息

主办方:

elexcon

第23届  
深圳国际电子展  
暨嵌入式展

elexcon 2026

博闻创意  
Creativity Exhibition

# 大会背景 ■

在人工智能算力需求爆发与摩尔定律放缓的产业根本矛盾驱动下,系统级封装(SiP)与先进封装技术已成为突破芯片性能瓶颈的核心路径。

作为中国最具影响力的SiP盛会,中国系统级封装大会自2017年以来,已汇聚全球250余家产业链领先企业及数千名专业观众,构建了前沿技术交流与高端产业融合的关键平台。上一届大会以“智聚芯能,异构互联”为主题,深刻探讨了AI时代的先进封装与Chiplet生态创新,获得业界广泛共鸣。

迈入2026年,产业发展步入从技术验证到规模化落地的攻坚期。面对从云端、智能汽车到边缘设备催生的复杂异构计算需求,以及Chiplet产业化、光电融合等趋势带来的全新挑战,产业焦点正从“为何集成”转向“如何高效、可靠、经济地集成”。

因此,本届大会将紧密围绕“设计与工艺协同”这一核心,设立两大专题论坛,旨在深度拆解从系统架构设计到底层材料工艺的全链条挑战,推动产业务实合作,共同引领下一代系统集成技术的创新与落地。

## 权威

作为全球聚焦于SiP  
系统级封装的重磅活动,历  
经9年,汇聚全球知名专家、智库和产  
业链优质资源



## 融合

融合产业链资源,从  
IC设计到晶圆制造、封测延  
伸至终端应用,推动产业  
链融合创新

## 聚焦

聚焦先进封测领域全  
新技术及市场动态、应用案  
例;是业界认可的应用解  
决方案和产品的  
发布平台



# 大会亮点

9

30

25,000<sup>+</sup>

成功举办9届(2017-2025)

全球30+国家/地区覆盖

累计25,000+行业人群参与



## 聚焦领域

- AI芯片
- 汽车电子
- 医疗
- 电子
- AI能源
- 物联网
- 数据中心算力芯片
- 存储



## 拟邀嘉宾

- EDA
- IP
- AI与算力芯片
- 存储
- OSTA
- 晶圆制造商
- 封装设备材料商
- 系统级运用厂商代表
- 学院研究机构专家
- 分析机构等



## 目标观众

- 服务器/智算中心
- AI硬件厂商
- 终端品牌商/EMS/OEM/ODM
- 研发
- OSAT/晶圆厂/Fabless
- 功率器件
- 光电元件等工艺制造
- 采购及高管

- Flux residue cleaning effectiveness
- Warpages induced opened joint
- SiP fine feature solder paste printing
- Thermal-induced reliability issue

# 热门议题 ■

## 分论坛一：面向AI与Chiplet的先进封装设计创新



AI超算集群的“封装级”互连设计挑战



Chiplet互连标准(UCle)的落地实践与生态瓶颈



面向异构集成的系统级协同优化与EDA工具演进



智能汽车舱驾一体SoC的SiP设计范式

## 分论坛二：突破系统级封装的制造边界与产业链协同



玻璃基板与新型载板技术的产业化进程



3D堆叠与混合键合的可靠性与量产良率提升



共封装光学(CPO)的封装集成解决方案与可靠性



先进封装中的热界面材料与散热终极方案

# 参与企业 ■

				帝尔激光   股票代码 300776.SZ

# 往届数据 ■

2025年SiP会议

1564

专业听众人次

40<sup>+</sup>

重磅嘉宾

50<sup>+</sup>

优质企业参与

# 往届嘉宾

排名不分先后



欧阳可青  
中兴微电子  
副总经理 IC平台研发中心主任



代文亮  
芯和半导体科技（上海）股份有限公司  
创始人&总裁



陈健  
阿里云智能集团 首席云服务器架构师  
研发总监 CXL和UCle董事会成员



祝俊东  
奇异摩尔（上海）半导体技术有限公司  
联合创始人 产品&解决方案副总裁



杨蕾  
IPC  
China标准经理



KLA  
Oksana.Gints  
Field Marketing Manager



李红宇  
AT&S  
高级经理



张康  
成都奕成科技股份有限公司  
研发总监



张修坤  
杜邦电子互连科技  
杜邦先进封装中国区销售负责人



胡清松  
广东鸿骐芯智能装备有限公司  
销售总监



谢志杰  
贺利氏电子  
SEMI业务开发经理



王宗源 博士  
华大九天  
市场拓展部高级技术经理



周军  
华岭申瓷  
副总经理



沈里正 博士  
环旭电子  
微小化创新研发中心 AVP



何野  
江苏英特神斯科技有限公司  
CTO



李建  
乐普科（上海）光电有限公司  
EQ & WQ 部门经理



吴政达  
沛顿科技  
副总经理



徐健  
奇异摩尔  
封装设计与运营总监



Bula Wang  
AT&S  
技术开发总监



黄俊贤  
锐德热力设备有限公司  
德国Rehm华南销售总监



周强  
上海光羽芯辰科技有限公司  
创始人兼董事长



张博威  
深圳市芯友微电子科技有限公司  
总经理



赵铁良  
深圳中科四合科技有限公司  
市场总监



方家恩  
苏州锐杰微科技集团有限公司  
董事长



周乐民  
武汉新创元半导体有限公司  
载板事业部营销总经理



## 大会赞助权益 ■

赞助类别	钻石赞助	铂金赞助	白银赞助	备注
大会演讲时段	✓	✓	✓	25-30分钟/场
独立展位	36m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	
大会对外宣传 LOGO展示	✓	✓	✓	
参观指南广告 内页	✓	—	—	实际尺寸: 142x210mm 加出血: 148x216mm
品牌X展架1个	✓	✓	—	尺寸: 80x180cm
宣传资料 入大会宣传袋	✓	✓	—	赞助商印刷提供
赞助套餐优惠价	¥100,000	¥80,000	¥50,000	

## 展位/赞助/演讲申请 ■



0755-88311535 elexcon.sales@cetimes.com